

## Carven-Module mit VIA-CPU

Die Carven-Module sind die kleinste und leistungsstärksten Module der VIA-Plattform. Sie sind in einer Größe von 99 mm x 59 mm untergebracht und bieten eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

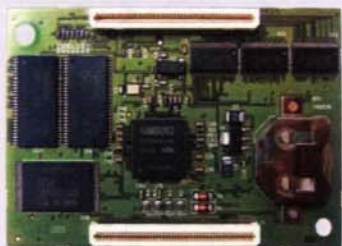
Adkom Elektronik, www.adkom.de  
Tel. (07161) 9589-0, Fax (07161) 9589-99

Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## 800-IPE von und mit VIA

Die 800-IPE-Module sind die kleinste und leistungsstärksten Module der VIA-Plattform. Sie sind in einer Größe von 99 mm x 59 mm untergebracht und bieten eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## CoM auf ARM-Basis



Der »MT-COM 1« von M-Tronic Design and Technology (Vertrieb: Adkom) ist ein Computer-on-Module mit einem ARM9-Microcontroller von Samsung. Der Microcontroller arbeitet mit einer Frequenz von 400 MHz und mit jeweils 64 MByte RAM und NAND-Flash. Das System ist auf einer kompakten Platine der Größe 99 mm x 59 mm untergebracht und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen

## 10-Zoll-IPE mit ATX oder Slot-CPU



Die 10-Zoll-IPE-Module sind die kleinste und leistungsstärksten Module der VIA-Plattform. Sie sind in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bieten eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

Die 10-Zoll-IPE-Module sind die kleinste und leistungsstärksten Module der VIA-Plattform. Sie sind in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bieten eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## Industrielles Mainboard



Das industrielle Mainboard ist ein High-End-Produkt für industrielle Anwendungen. Es ist in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## ISA-Merie mit Intel Atom

Die ISA-Merie mit Intel Atom ist ein High-End-Produkt für industrielle Anwendungen. Es ist in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## Media-Player



Das Media-Player-Modul ist ein High-End-Produkt für industrielle Anwendungen. Es ist in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)

## VME-CPU mit Allview-Engine

Die VME-CPU mit Allview-Engine ist ein High-End-Produkt für industrielle Anwendungen. Es ist in einer Größe von 100 mm x 100 mm untergebracht und bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten: ein USB-1.1-Client-Interface, ein USB-1.1-Host-Interface, Audioschnittstellen und ein TFT-Interface zum Anschluss von TFT-Panels mit optionalen resistiven 4-Wire Touchscreens. Darüber hinaus gibt es serielle Schnittstellen, ein SD-Card-Interface, I<sup>2</sup>S, SPI und ein Kamera-Interface (ITU-R BT. 601/656). Zur Verbindung des CoM mit der übrigen Hardware sind die Module mit je zwei 100-poligen Steckverbindern ausgestattet. (mk)